

設計革新セミナーの開催のご案内

第 427 回（2011 年 3 月度）例会

主催：東京設計管理研究会

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は、当研究会に対しまして、格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、標記のセミナーを下記要領にて開催いたしますので、ご多用のことと存じますがご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。

なお、セミナーへの出欠の確認をさせていただきますので、別紙「セミナー参加申込書」にご記入の上、FAX 又は電子メールにて **2月28日(月)必着**で担当幹事までご連絡のほどお願いいたします。

敬具

記

1. 日 時：2011年3月9日(水) 14:00～17:00

会場は飯田橋です

2. 開催場所：株式会社 フォトロン (PHOTRON LIMITED)

3F セミナールーム (直接会場へお越し下さい)

(住所) 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-1-8 千代田富士見ビル

(案内図参照)

(TEL) 03-3238-2170

開催担当：株式会社 フォトロン

伊藤 賢一 様

3. プログラム

(1). 会長挨拶 (14:00～14:10)

(2). 主催会社挨拶、紹介 (14:10～14:40)
新製品 (低価格 3D CAD) 等の紹介を致します。

(3). 発表 1 (14:40～15:40)

(テーマ) 日本企業は生き残れるか

(発表者) 東京設計管理研究会 学会会員 大滝 英征 様

(発表概要) 前回には、アーキテクチャー (すり合わせ技術、組み合わせ技術、ビジネスモデルの構築) の展開という側面から、日本企業の生きる路について述べた。日本、アメリカ、中国の展開には大きな差異があり、日本が敗北の危機に立たされていることにも触れた。

日本が生き残るためには、従前とは全く異なったビジネスモデルとアーキテクチャーを構築しなくてはならない。これに該当するものとしてライフケアに関する技術を挙げた。これは、高度化された先進医療に関するビジネスモデルであった。

しかし、世界には飲まず食わずの状態、生き延びることが精一杯の人たちもいる。このような人達をも対象にし、率先して技術開発していくのが本来的な姿と考える。しかしジワリと中国風の戦略が行き渡ってきている。

中国政府がアフリカに目を向けている（天然資源開発やインフラ整備も含めて）ことは自明である。このままでは、国を挙げて勢力拡大を狙う中国と欧米等の狭間でどんどん日本の居場所がなくなることが危惧される。

アフリカの現状と、日本の開発すべきビジネスモデルとアーキテクチャーについて自論を述べる。

休憩 (15:40 ~ 15:50)

(4). 新入会企業挨拶・紹介 (15:50 ~ 16:10)

①株式会社アーネストエキスパートサービス

和久 憲一 (わく けんいち) 様

②株式会社サンコー ビジネスソリューションセンター東京

青柳 英樹 (あおやぎ ひでき) 様

休憩 (16:10 ~ 16:15)

(5). 発表2 (16:15 ~ 16:55)

(テーマ) 製品紹介「黒田精工におけるモータコア用金型の概要と展望」

(発表者) 黒田精工株式会社 技術本部 開発センター 長野工場駐在

山内 正裕 (やまうち まさひろ) 様

(発表概要) 弊社の源流はゲージの製造販売であり、設立は1925年に遡ります。

ゲージ製造の技術・技能を活かし、1946年に精密プレス金型の製造販売を、1976年からは順送り積層プレス金型の製造販売を開始しました。

順送り積層金型（商品名“FASTEC”（ファステック））では、金型で打ち抜いた鋼板を金型内で積層（積み重ね）し、さらに固着させることができます。現在、“FASTEC”で製造するワークは、主に電気モータで使われるステータ及びロータ（総称“モータコア”又は単に“コア”）です。モータの用途別では、携帯電話の着信を知らせるバイブレーション用モータから洗濯機・エアコンなどの家電用モータ、産業用モータ、最近ではハイブリットカーのモータなど、あらゆる分野に渡っています。

弊社では、この“FASTEC”を鋼板の固着方法によって3つに分類しています。

① 一般的なカシメによるFASTEC金型

② レーザー加工を組み合わせたレーザーFASTEC金型

③ 鋼板の固着に接着剤を使用するGlue FASTEC金型

レーザーFASTEC金型は、カシメが困難な極小コアを高精度に、かつ量産を可能にしました。Glue FASTEC金型は、薄い鋼板の積層を可能にし、さらにモータの鉄損を低減させるというメリットをもっており、環境対応に有効です。この度のセミナーでは、これら“FASTEC”金型群について、その概要を、今後の展望を交えて紹介いたします。

(5) 総合質疑応答 (16:55~17:00)

注) セミナー終了後、有志参加による懇親会 (有料) を予定しておりますので、ご都合がつかまず方はご参加ください。会費は¥3000を予定しております。
(事前準備のためセミナー参加申し込み書に添えて希望者を確認させていただきます。)

以上

3月度担当幹事 : 株式会社 サンコー
 ビジネスソリューションセンター東京 笹隈俊一
 TEL: 03-5402-3568 FAX: 03-5402-3569
 E-mail: sasakuma@hkr.jrnet.ne.jp

2011年3月度 東京 EAC 設計革新セミナー申込書 (FAX 通信用)

東京設計管理研究会 3月度担当幹事
 株式会社 サンコー 笹隈俊一 行き
 <2月28日(月)までに回答願います>
 *E-mailにてご回答の場合は参加・不参加のみお知らせください。
 FAX: 03-5402-3569 E-mail: sasakuma@hkr.jrnet.ne.jp

2011年3月度 東京 EAC 設計革新セミナーに:

	セミナー	懇親会
出席します	()	()
欠席します	()	

会社名:
 出席者名:

〔案内図〕

株式会社 フォトロン (PHOTRON LIMITED)

3F セミナールーム (直接会場へお越し下さい)

(住所) 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-1-8 千代田富士見ビル (案内図参照)

